

中国国际金融股份有限公司

关于合肥晶合集成电路股份有限公司

2026 年半年度持续督导跟踪报告

中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，作为合肥晶合集成电路股份有限公司（以下简称“晶合集成”或“公司”）持续督导工作的保荐机构，针对晶合集成 2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日（以下简称“报告期”）经营情况，出具本持续督导半年度跟踪报告。

一、持续督导工作情况

序号	工作内容	持续督导情况
1	建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对具体的持续督导工作制定相应的工作计划	保荐机构已建立健全并有效执行了持续督导制度，并制定了相应的工作计划。
2	根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报上海证券交易所备案	保荐机构已与晶合集成签订保荐协议，该协议明确了双方在持续督导期间的权利和义务，并报上海证券交易所备案。
3	持续督导期间，按照有关规定对上市公司违法违规事项公开发表声明的，应于披露前向上海证券交易所报告，并经上海证券交易所审核后在指定媒体上公告	2026 年上半年度晶合集成在持续督导期间未发生按有关规定需保荐机构公开发表声明的违法违规情况。
4	持续督导期间，上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的，应自发现或应当发现之日起五个工作日内向上海证券交易所报告，报告内容包括上市公司或相关当事人出现违法违规、违背承诺等事项的具体情况，保荐机构采取的督导措施等	2026 年上半年度晶合集成在持续督导期间未发生违法违规或违背承诺等情况。
5	通过日常沟通、定期回访、现场检查、尽职调查等方式开展持续督导工作	保荐机构通过日常沟通、定期或不定期回访等方式了解晶合集成业务情况，对晶合集成开展了持续督导工作。

序号	工作内容	持续督导情况
6	督导上市公司及其董事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，并切实履行其所做的各项承诺	2026 年上半年度，保荐机构督导晶合集成及其董事、高级管理人员遵守法律、法规、部门规章和上海证券交易所发布的业务规则及其他规范性文件，切实履行其所作出的各项承诺。
7	督导上市公司建立健全并有效执行公司治理制度，包括但不限于股东会、董事会议事规则以及董事、高级管理人员的行为规范等	保荐机构督促晶合集成依照相关规定健全完善公司治理制度，并严格执行公司治理制度。
8	督导上市公司建立健全并有效执行内控制度，包括但不限于财务管理制度、会计核算制度和内部审计制度，以及募集资金使用、关联交易、对外担保、对外投资、衍生品交易、对子公司的控制等重大经营决策的程序与规则等	保荐机构对晶合集成的内控制度的设计、实施和有效性进行了核查，晶合集成的内控制度符合相关法规要求并得到了有效执行，能够保证公司的规范运营。
9	督导上市公司建立健全并有效执行信息披露制度，审阅信息披露文件及其他相关文件，并有充分理由确信上市公司向上海证券交易所提交的文件不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏	保荐机构督促晶合集成依照相关规定健全和完善信息披露制度并严格执行，审阅信息披露文件及其他相关文件。
10	对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、上海证券交易所提交的其他文件进行事前审阅，对存在问题的信息披露文件及时督促上市公司予以更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	保荐机构对晶合集成的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。
11	对上市公司的信息披露文件未进行事前审阅的，应在上市公司履行信息披露义务后五个交易日内，完成对有关文件的审阅工作，对存在问题的信息披露文件应及时督促上市公司更正或补充，上市公司不予更正或补充的，应及时向上海证券交易所报告	保荐机构对晶合集成的信息披露文件进行了审阅，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。
12	关注上市公司或其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员受到中国证监会行政处罚、上海证券交易所纪律处分或者被上海证券交易所出具监管关注函的情况，并督促其完善内部控制制度，采取措施予以纠正	2026 年上半年度持续督导期间内，晶合集成及其控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员未发生该等事项。
13	持续关注上市公司及控股股东、实际控制人等履行承诺的情况，上市公司及控股股东、实际控制人等未履行承诺事项的，应及时向上海证券交易所报告	2026 年上半年度持续督导期间内，晶合集成及其控股股东、实际控制人不存在未履行承诺的情况。
14	关注社交媒体关于上市公司的报道和传闻，及时针对市场传闻进行核查。经核查后发现上市公司存在应披露未披露的重大事项或披露的信息与事实不符的，及时督促上市公司如实披露或予以澄清；上市公司不予披露或澄清的，应及时向上海证券交易所报告	2026 年上半年度持续督导期间内，经保荐机构核查，不存在应及时向上海证券交易所报告的情况。

序号	工作内容	持续督导情况
15	发现以下情形之一的，保荐机构应当督促上市公司做出说明并限期改正，同时向上海证券交易所报告：（一）涉嫌违反《股票上市规则》等本所业务规则；（二）中介机构及其签名人员出具的专业意见可能存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏等违法违规情形或其他不当情形；（三）公司出现《保荐办法》第七十条规定的情形；（四）公司不配合保荐机构持续督导工作；（五）上海证券交易所或保荐机构认为需要报告的其他情形	2026 年上半年度持续督导期间内，晶合集成未发生左述情况。
16	保荐机构应当制定对上市公司的现场检查工作计划，明确现场检查工作要求，确保现场检查工作质量	保荐机构已制定了现场检查的相关工作计划，并明确了现场检查工作要求。
17	上市公司出现下列情形之一的，保荐机构、保荐代表人应当自知道或者应当知道之日起十五日内进行专项现场核查：（一）存在重大财务造假嫌疑；（二）控股股东、实际控制人及其关联人涉嫌资金占用；（三）可能存在重大违规担保；（四）控股股东、实际控制人及其关联人、董事或者高级管理人员涉嫌侵占上市公司利益；（五）资金往来或者现金流存在重大异常；（六）上海证券交易所或者保荐机构认为应当进行现场核查的其他事项。	本持续督导期间，晶合集成不存在需要专项现场检查的情形。

二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

无。

三、重大风险事项

（一）核心竞争力风险

1、研发人员不足或流失风险

集成电路晶圆代工行业不仅是资本、技术密集型行业，同时也具有人才高度密集型特征。随着集成电路行业竞争持续加剧，懂行业、精技术、善管理的人员团队是公司持续发展的基石，人才现已成为公司关键的战略资源。为此，公司将人才梯队建设置于重要位置，通过实施员工持股计划、股权激励、完善职业发展通道等多元化举措，积极吸引并留住高端技术人才，现已组建起一支经验丰富、稳定可靠、创新能力卓越的核心研发团队，在新产品与先进制程的研发及量产方面发挥了关键作用。尽管正常范围内的人才流动通常不会对研发与经营造成重大不利影响，但若

未来核心技术人员出现较大范围的流失，仍可能在一定时期内对相关项目的研发进度、技术迭代及工艺稳定性带来挑战，从而对公司的市场竞争地位产生不利影响。

2、产品开发风险

集成电路晶圆代工行业技术复杂程度高、迭代速度快，且下游应用需求多元。公司需持续进行高强度的研发投入，以跟进技术发展趋势并响应客户需求。然而，新工艺平台从研发、验证到最终实现规模化量产，通常研发周期长、资金投入大且结果存在不确定性。若公司未能及时完成关键技术迭代，或性能及良率不达标，可能导致新产品无法顺利开发完成或无法通过客户的认证，致使公司发展后劲不足，在市场竞争中处于不利地位。

3、核心技术外泄或失密风险

经过多年的技术创新和研发积累，公司储备了一系列具有自主知识产权的核心技术，拥有覆盖研发及生产全流程的上千项专利。同时，公司仍在持续进行多项针对主营业务的技术研发工作，累积了众多的实验数据、工艺参数、设计图纸等商业秘密。公司十分重视对核心技术的保护工作，通过申请专利、计算机软件著作权、集成电路布图设计等方式对核心技术进行有效保护，并制定了保密制度，对核心技术人员在保密义务、知识产权等方面作出了严格规定。同时，通过对访问权限划分、敏感信息监控等方式加强网络安全管理，以保护公司的合法权益，防止核心技术外泄。但由于技术秘密保护措施的限制及其他不可控因素，在人员流动、上下游业务交流的过程中，公司的技术和研发成果仍面临一定的泄密风险，从而对公司核心竞争力产生风险。

（二）经营风险

1、客户集中度较高的风险

报告期内，公司前五大客户的销售收入合计 342,688.59 万元，占营业收入的比例为 57.53%，客户集中度较高。公司凭借自身的研发能力、产品品质、产能支持、客户服务等综合能力，已与主要客户保持了良好的合作关系并与部分客户签署了长期合作的框架协议。但未来若公司的主要客户因产品布局优化、技术路径转变、下游需求变化等因素调整采购策略，或者公司自身在产品研发、产能供应等方面未能

持续满足客户需求，导致订单量大幅下降、价格下调，且公司未能及时开拓足量新客户以弥补需求缺口，将可能对公司生产经营和盈利能力产生不利影响。

2、新产品需求不及预期风险

公司一直重视新产品、新制程和特色工艺平台的研发工作，目前公司 90nm 高阶近红外感光图像传感器实现小批量生产，28nm 逻辑工艺平台已导入客户样品流片验证中，22nm 逻辑芯片工艺开发中，新产品的陆续研发完成并通过认证及量产，将会给公司经营业绩带来新的增长点。然而，开发新技术平台及实现商业化，所需的资金、时间成本高，叠加市场需求及行业竞争态势变化等多重不确定性。若公司新产品落地时无法满足现时市场需求或未能获得客户的充分认可，可能导致研发投入无法取得预期回报，从而影响公司的成长速度与盈利能力。

3、公司产品结构相对集中的风险

公司主要从事 12 英寸晶圆代工业务，目前的主要产品包括 DDIC、CIS、PMIC、Logic 和 MCU。报告期内公司主营业务收入主要来自于 DDIC，该产品营收占比约为 53.24%，较上年同期下降 7.37 个百分点，此外 CIS 产品的营收占比约为 25.34%，较上年同期提升 4.83 个百分点，公司产品结构有所改善。公司目前正在进行新技术平台的研发和持续优化工作，并积极开拓市场，但新产品形成规模收入尚需时间。短期内，如果面板显示驱动芯片市场、图像传感器市场需求下降，导致公司在该领域的生产或销售出现不利变化，则可能对公司的盈利能力、经营性现金流产生不利影响。

4、公司无法及时消化新增产能的风险

为把握市场机遇，公司依据市场环境、客户需求、公司发展战略等进行弹性产能扩充，并已进行了深入的市场调研和可行性分析，在技术工艺、市场开拓、人员储备等方面做好了充分准备，但产能建设与释放需要一定周期，外部环境的不确定性仍可能带来挑战。未来若宏观经济环境、国家产业政策或技术发展方向发生重大变化，导致下游市场增速不及预期、公司主要客户需求改变，或其他同业竞争者加速扩产导致市场供需失衡等情形，公司将面临产能释放节奏和市场需求节奏不匹配致使无法及时消化新增产能的风险，进而导致产能利用率下滑、固定资产折旧压力

增大，对公司的经营业绩造成不利影响。

（三）财务风险

1、固定资产投资的风险

公司所处的集成电路行业是典型的资本密集型行业，固定资产投资规模较大。为把握市场机遇、提升客户服务能力及强化市场地位，公司持续推进产能扩张战略。尽管已制定审慎的资本开支计划并配套多元化融资方案，但在产能实际建置过程中，受制于宏观经济波动、货币政策调整及资本市场融资环境变化等不可控因素，公司可能面临一定的资金压力。与此同时，随着大额固定资产的增加，折旧费用也将相应上升，但经济效益提升需要一定的时间，若公司未来产销规模的增长无法消化大额固定资产投资带来的新增折旧，可能会对公司的盈利水平产生阶段性压力。

2、存货跌价风险

报告期末，公司的存货账面价值为 159,002.26 万元，占总资产比例为 2.70%；存货跌价准备金额为 3,912.30 万元，对应存货期末余额的计提比例为 2.40%。公司的生产策略以销售订单为核心，并考虑客户的中期需求来制定生产计划，进行适度备货，以保证销售与生产的匹配与衔接。若未来市场环境发生不利变化、客户需求出现非预期调整或技术迭代加速，而公司未能及时有效应对并做出相应调整，将导致产品滞销、存货积压，公司将面临存货跌价的风险。

3、毛利率波动风险

报告期内，受产品结构、竞争压力、产品价格等因素影响，公司综合毛利率有一定的波动。公司的产品规格数量较多，不同制程和品类的产品在价格与毛利率上存在一定差异，产品结构的调整将直接影响毛利率水平。同时，公司成本结构中以固定成本为主，主要包含厂房、设备折旧等，因此价格和稼动率的波动对毛利率影响较大。未来，如果市场供需关系、公司议价能力、技术发展趋势等发生重大不利变化，导致公司营业收入规模出现显著波动，或流失高毛利率业务，或新增产能未达预期稼动率，公司将面临毛利率波动甚至下滑的风险。

4、外币汇率波动风险

报告期内，公司存在境外销售及采购的情况，并主要通过美元或日元进行结算，公司相应持有美元、日元等外币货币性资产。虽然公司在业务开展时已考虑了订单签订及款项收付期间汇率可能产生的波动，也持续平衡外币货币性资产规模以降低汇兑损益对经营业绩的影响，但如果未来境内外经济环境、政治形势、货币政策等因素发生变化，使得外币汇率大幅波动，公司有可能面临汇兑损失的风险。与此同时，如果结算汇率短期内波动较大，公司境外原材料采购价格和产品销售价格也将受到影响，进而可能对经营业绩造成不利影响。此外，公司在香港设立经营主体开展业务，其后公司于 2026 年 7 月 10 日在香港联交所挂牌上市，港币汇率的波动亦可能导致公司承担汇兑损失。

（四）行业风险

1、产业政策变化风险

集成电路产业是我国的战略性支柱产业，近年来国家陆续出台文件进行积极引导，自上而下地为行业构建了系统性的支持体系。各级地方政府亦同步配套税收优惠、融资支持、财政补贴、人才引进及知识产权保护等一揽子举措，为产业链各环节企业营造了良好的发展环境。在政策驱动下，国内集成电路行业在芯片设计研发、先进制程工艺突破及关键核心技术自主可控等方面取得显著进步。若未来产业政策方向发生调整（如财税优惠退坡、补贴力度减弱或行业准入规则变化等），可能对公司技术研发、高端人才储备及产能扩张节奏产生潜在不利影响。

2、行业竞争加剧的风险

近年来，集成电路行业在国家政策引导及地方产业配套支持下已形成高速增长态势，良好的行业前景吸引了更多的市场新进入者以及资本力量的汇聚，共同推动了行业的繁荣。然而，伴随产能规模化释放，市场供给不断增加，行业竞争进一步加剧。尽管公司通过自主研发，在工艺迭代、新产品开发方面取得了不错的进展，并构建了较为完整的技术储备与量产经验体系，但在核心技术壁垒构建、高端市场渗透能力等方面仍与行业龙头企业存在一定差距。未来，倘若行业产能供应过剩、竞争对手推出新技术、公司不能准确把握市场需求变化趋势以及及时调整竞争策略，可能导致公司产品定价承压、市场份额下滑，从而对公司的业务、财务状况及经营业绩造成不利影响。

3、供应链风险

集成电路行业对核心原材料、精密零部件、专用软件及高端设备的品质与适配性具有严苛标准，是保证公司稳定生产的必要条件，但部分重要原材料、零部件、专用软件、核心设备等的全球合格供应商数量较少，部分供应商可能位于地缘政治不稳定的地区。尽管公司持续强化供应链安全体系建设，积极推动关键设备及材料的国产化替代，以降低对外部供应的依赖，但国际贸易环境不确定性的影响依然存在。若因地缘政治等其他不可抗力的因素，导致公司的重要材料、零备件、软件、设备等的出口许可、物流受到限制或成本上涨，将对公司产能规划实施效率、技术迭代进度、客户关系维系带来潜在不利影响，从而影响公司的整体运营和发展。

（五）宏观环境风险

1、国际贸易摩擦加剧的风险

在全球经济一体化的大环境下，国家之间的经济往来与政治互动紧密相关，国际形势的变动直接影响着国际贸易的格局，也对特定产业的发展产生深远影响。近年来，国际贸易摩擦不断，集成电路产业成为贸易冲突的重点领域，部分国家采用提高关税、出口管制、技术限制等非市场化干预措施，客观上制约我国产业链生态协同发展进程。尽管公司在经营过程中始终遵守中国及他国法律法规，并积极构建多元化供应链与市场布局以规避单一区域风险，但国际环境的复杂性和多变性意味着，国际贸易政策可能突然发生不利变更，将对公司的业务拓展和供应链管理带来限制，进而影响公司的正常运营。

2、宏观经济波动和行业周期性风险

公司主要从事集成电路相关产品研发、生产及销售，属于集成电路行业的中游环节。半导体行业具备显著的周期性，整体经营业绩与宏观环境、下游终端产业景气度高度绑定。若未来宏观经济形势发生重大变化，下游终端产业需求低迷，将导致 IC 设计公司新产品发布延迟、下游厂商备货策略趋于谨慎或施加更大的定价压力，包括公司在内的集成电路企业将面临一定的行业波动风险，对经营情况造成不利影响。

四、重大违规事项

2026 年上半年度持续督导期间，晶合集成不存在重大违规事项。

五、主要财务指标的变动原因及合理性

2026 年 1-6 月，晶合集成主要会计数据如下所示：

单位：元

主要会计数据	2026年1-6月	2025年1-6月	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入	5,956,673,576.99	5,198,454,703.34	14.59
利润总额	235,600,669.30	232,046,990.31	1.53
归属于上市公司股东的净利润	245,372,807.46	332,128,758.87	-26.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	130,625,822.45	203,831,533.70	-35.91
经营活动产生的现金流量净额	2,797,993,046.82	1,705,034,907.06	64.10
主要会计数据	2026年6月末	2025年末	本报告期末比上年度末增减（%）
归属于上市公司股东的净资产	23,289,779,621.83	21,768,532,119.02	6.99
总资产	58,782,603,348.89	53,297,969,295.77	10.29

2026 年 1-6 月，晶合集成主要财务指标如下所示：

主要财务指标	2026年1-6月	2025年1-6月	本报告期比上年同期增减（%）
基本每股收益（元 / 股）	0.13	0.17	-23.53
稀释每股收益（元 / 股）	0.13	0.17	-23.53
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.07	0.10	-30.00
加权平均净资产收益率（%）	1.09	1.58	减少0.49个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	0.58	0.97	减少0.39个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	12.75	13.37	减少0.62个百分点

报告期内，晶合集成上述主要财务数据及指标的变动原因如下：

营业收入较上年同期增加 75,821.89 万元，同比增长 14.59%，主要系报告期公司产品销量增加，收入规模持续增长所致。

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期减少 7,320.57 万元，同比下降 35.91%，主要系：①市场竞争加剧，产品价格有所波动，受生产周期影响，部分产品价格上调带来的积极影响尚未在当期业绩中充分体现，叠加固定资产折旧增加，导致综合毛利率短期有所下滑；②受股权激励影响导致公司成本增加。

经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加 109,295.81 万元，同比增长 64.10%，主要系本报告期营业收入同比增长，销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。

扣除非经常性损益后的基本每股收益为 0.07 元/股，较上年同期减少 0.03 元/股，主要系本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比下降所致。

六、核心竞争力的变化情况

（一）研发团队经验丰富，技术实力行业领先

公司研发团队核心成员均由境内外的资深专家组成，在不同的技术方向具有丰富的研发经验，对行业发展现状和趋势有着深刻的认识和理解。公司坚持以行业发展趋势和客户需求为导向，积极探索新的业务领域，及时进行产品迭代，满足终端客户的需求。通过多年持续的研发投入，公司积累了深厚的技术储备和丰富的研发经验，截至报告期末，公司共取得专利 1,648 个，其中发明专利 1,294 个、实用新型专利 354 个。报告期内，公司研发投入金额达 75,949.75 万元，较上年同期增长 9.31%。报告期末公司拥有员工 5,738 名，其中研发人员 1,938 名，占员工总数比例为 33.77%，研发人员中硕士及以上占比约 67.29%。

（二）产品结构不断丰富，工艺平台多元发展

公司已实现 DDIC、CIS、PMIC、Logic、MCU 等工艺平台量产，产品结构日益多样化，产品应用涵盖消费电子、汽车电子、工业控制、人工智能、物联网及存储等领域。报告期内，公司不断推出有市场竞争力的新产品，进一步优化产品结构，

DDIC 营收占比逐渐下降，CIS、PMIC 营收占比不断提升。

（三）位居合肥战略核心，产业链协同效应强

公司地处国家级科创试点城市合肥。合肥凭借“芯屏汽合”产业战略，已形成新型显示、集成电路、新能源汽车及人工智能等新兴产业集群，并集聚了众多集成电路产业链上下游重点企业，构建了覆盖设计、制造、封装测试、装备材料及公共服务平台的完整生态。作为集成电路产业链的核心环节，公司充分发挥本地终端市场距离近、规模大的优势，依靠成熟制程制造经验，深度融入合肥产业链布局，提供关键芯片供给，有力促进产业链协同联动，共建稳定共赢的产业生态圈。

（四）稳定灵活的产能供应，客户关系紧密稳固

作为领先的晶圆代工企业，公司为客户提供稳定灵活的产能规划、全面的技术支持与可靠的产品交付。公司高度重视关键客户的定制化需求，通过共同开发与工艺验证，满足其特定应用，保障客户在快速发展的终端市场竞争中的确定性及灵活性，进而深化客户粘性。这种深度合作不仅助力公司精准洞察市场与技术趋势、缩短产品上市时间并提升整体产品性能，更构建了长期稳固的客户网络，为可持续增长奠定坚实基础，并赢得了众多境内外知名芯片设计与终端产品企业的广泛认可。

（五）体系认证齐全，质量稳定可靠

公司建立了完善的质量管理体系，依托产品研发及工艺技术的综合实力保证并提升产品品质。截至目前，公司已取得质量管理体系认证 ISO9001、环境管理体系认证 ISO14001、职业健康安全管理体系认证 ISO45001、有害物质过程管理体系认证 QC080000、温室气体排放盘查认证 ISO14064、能源管理体系认证 ISO50001:2018 等诸多认证。此外，在车用芯片领域，公司已取得车载质量管理体系 IATF16949 认证。

（六）智能化工厂运营和本地集中化产业链优势

公司已整合智能制造系统及 AI 智能制造工具，构建覆盖生产全流程的智能化体系。智能生产线配备了先进的智能制造运营管理系统，包括数字化生产系统、自动化无人搬运系统、车间自动化控制系统、智能品质与设备监控系统及智能生产派工系统等，显著提升了生产效率与质量管理水平。通过智能化生产，公司为客户提供

了卓越的代工服务与稳定可靠的产品质量，通过将人工智能技术全面融入研发与运营等核心环节，公司有效地提升管理效能、降低运营成本，实现了 AI 驱动的智能制造升级与全局优化。

公司所有产能均集中于中国合肥的同一厂区，通过在此基础上有序、稳步地扩充产能，可有效减少重复建设，自动化晶圆传送系统贯穿整个厂区，将显著提升投资效益并优化产能调度。同时，公司还积极努力推动关键原材料及设备的国产化，降低对进口材料及设备的依赖，缩短采购交期，增强供应链稳定性。高度一体化的生产基地、智能生产及本土化供应链支持，使公司具备更高效率、更佳质量及更雄厚的成本竞争力。

七、研发支出变化及研发进展

（一）研发支出及变化情况

单位：元

项目	2026 年 1-6 月	2025 年 1-6 月	变化幅度（%）
费用化研发投入	609,226,688.90	694,820,162.03	-12.32
资本化研发投入	150,270,803.66	-	不适用
研发投入合计	759,497,492.56	694,820,162.03	9.31
研发投入总额占营业收入比例（%）	12.75	13.37	减少 0.62 个百分点
研发投入资本化的比重（%）	19.79	-	增加 19.79 个百分点

（二）研发进展

报告期内，公司通过整合现有研发资源，优化研发配置，针对关键研发重点、难点进行集中攻坚，在高阶车用及旗舰手机摄像头领域持续突破，具体如下：（1）55nm 高效能高动态范围成像技术图像传感器工艺平台开发完成；（2）90nm 高阶近红外感光图像传感器实现小批量生产。

报告期内，公司研发投入 75,949.75 万元，较上年同期增长 9.31%，占公司营业收入的 12.75%。报告期末公司共有员工 5,738 人，其中研发人员 1,938 人，占比 33.77%。报告期内公司新获得发明专利 240 个、实用新型专利 37 个。截至报告期末

公司累计获得专利 1,648 个。

报告期内，公司研发进展顺利，取得了显著的成果，新产品逐步导入市场，如 90nm 高阶近红外感光图像传感器实现小批量生产。

八、新增业务进展是否与前期信息披露一致（如有）

不适用。

九、募集资金的使用情况及是否合规

（一）募集资金使用情况

经中国证券监督管理委员会于 2022 年 5 月 9 日出具的《关于同意合肥晶合集成电路股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕954 号）同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A 股）501,533,789 股。公司每股发行价格 19.86 元，募集资金总额为 9,960,461,049.54 元，扣除发行费用 236,944,589.63 元后，募集资金净额为 9,723,516,459.91 元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行的资金到位情况进行了审验，并于 2023 年 4 月 26 日出具了《验资报告》（容诚验字[2023]230Z0099 号）。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2023 年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2023 年 4 月 26 日
本次报告期	2026 年 1 月 1 日至 2026 年 6 月 30 日
项目	金额
募集资金净额	9,723,516,459.91
加：利息收入扣除银行手续费净额	122,054,018.25
减：募集资金投资项目支出(a+b+c)	8,789,181,314.29
其中：直接投入募集资金项目的金额(a)	5,267,663,497.79
以募集资金置换预先投入项目的自筹资金的金额(b)	2,075,224,554.41

使用基本存款账户、银行电汇及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的金额(c)	1,446,293,262.09
减：节余资金永久补充流动资金	831,868,466.31
减：超募资金永久补充流动资金	60,000,000.00
减：超募资金回购公司股份	164,520,697.56
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金专户应有余额(d)	0
截至 2026 年 6 月 30 日募集资金专户实际余额(e)	0
差异(d-e)	0

公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票注册管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求制定了《合肥晶合集成电路股份有限公司募集资金管理制度》，对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。

根据上海证券交易所及有关规定的要求，公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司以及募集资金专户所在银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金实行专户管理。上述监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截至 2026 年 6 月 30 日，《募集资金专户存储三方监管协议》得到了切实履行。

截至 2026 年 6 月 30 日，募集资金存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2023 年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2023 年 4 月 26 日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
合肥晶合集成电路股份有限公司	合肥科技农村商业银行股份有限公司七里塘支行	20000515418466600000057	0	2026 年 3 月 19 日销户
	合肥科技农村商业银行股份有限公司七里塘支行	20000515418466600000164	0	2026 年 3 月 19 日销户

中国银行股份有限公司合肥庐阳支行	181267662902	0	2026 年 3 月 18 日销户
中国农业银行股份有限公司合肥金寨路支行	12181001040035296	0	2026 年 3 月 18 日销户
招商银行股份有限公司合肥分行	551904996610555	0	2024 年 7 月 17 日销户
兴业银行股份有限公司合肥望江东路支行	499050100100419345	0	2024 年 7 月 19 日销户
中国工商银行股份有限公司合肥四牌楼支行	1302010129200389609	0	2024 年 5 月 17 日销户
中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行	34050144770800002618	0	2026 年 3 月 19 日销户

1、对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于 2025 年 4 月 28 日召开了第二届董事会第二十次会议和第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响公司募投项目实施和资金安全的情况下，使用不超过人民币 15 亿元（含本数）闲置募集资金进行现金管理，使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-023）。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的余额为 0。

2、节余募集资金使用情况

公司于 2026 年 2 月 6 日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，公司董事会同意将募投项目“后照式 CMOS 图像传感器芯片工艺平台研发项目（包含 90 纳米及 55 纳米）”“28 纳米逻辑及 OLED 芯片工艺平台研发项目”结项，并将节余募集资金 13,304.90 万元（截至 2026 年 1 月 31 日，含扣除手续费后的利息收入、理财收益、尚未支付的款项及用自有资金支付且未置换的发行费用，实际金额以资金转出当日专户余额

为准)永久补充流动资金,用于公司日常生产经营。该事项是根据募投项目实施的实际情况做出的审慎决定,不存在违规使用募集资金的情形,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,也不存在损害股东利益的情形。该议案无需提交公司股东会审议。具体内容详见公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《晶合集成关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2026-001)。

截至《合肥晶合集成电路股份有限公司 2026 年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》出具日,公司已将节余募集资金 130,760,668.56 元从募集资金存放专项账户转出用于补充流动资金,另有前期以自有资金支付且未置换的发行费用 2,431,486.99 元,本次随节余资金一同转出。公司在合肥科技农村商业银行股份有限公司七里塘支行开立的账号为 20000515418466600000057、20000515418466600000164 的募集资金专户已于 2026 年 3 月 19 日办理销户手续;在中国农业银行股份有限公司合肥金寨路支行开立的账号为 12181001040035296 的募集资金专户已于 2026 年 3 月 18 日办理销户手续;在中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行开立的账号为 34050144770800002618 的募集资金专户已于 2026 年 3 月 19 日办理销户手续。

节余募集资金使用情况表

单位:元 币种:人民币

发行名称			2023 年首次公开发行股份				
募集资金到账日期			2023 年 4 月 26 日				
节余募集资金合计金额			130,760,668.56				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
后照式 CMOS 图像传感器芯片工艺平台研发项目(包含	130,728,028.59	用于补流	不适用	不适用	不适用	2026 年 2 月 6 日	不适用

90 纳米及 55 纳米)							
28 纳米逻辑及 OLED 芯片工艺平台研发项目	32,639.97	用于补流	不适用	不适用	不适用	2026 年 2 月 6 日	不适用

3、募集资金使用的其他情况

2023 年 6 月 21 日，公司召开第一届董事会第十七次会议和第一届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于使用基本存款账户、银行电汇及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在确保不影响募投项目建设和募集资金使用计划以及确保公司正常运营的前提下，使用基本存款账户、银行电汇及信用证等方式支付募投项目部分款项，再以募集资金等额置换。具体内容详见公司于上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《晶合集成关于使用基本存款账户、银行电汇及信用证等方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2023-006）。

截至 2026 年 6 月 30 日，公司使用基本存款账户、银行电汇及信用证等方式累计支付了募投项目所需资金共计 1,446,293,262.09 元，以募集资金 1,446,293,262.09 元进行了等额置换。

除上述情况外，报告期内，公司不存在募集资金使用的其他情况。

4、变更募投项目的资金使用情况

公司于 2024 年 12 月 30 日召开第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的议案》，董事会同意本次终止募投项目“微控制器芯片工艺平台研发项目（包含 55 纳米及 40 纳米）”，并将该项目拟投入募集资金 35,595.58 万元（含现金管理收益及利息收入，实际金额以资金转出当日专户的募集资金余额为准）变更投向至其他募投项目“28 纳米逻辑及 OLED 芯片工艺平台研发项目”，并授权公司管理层及其授权人士在股东会审议通过本次事项后办理开立募集资金专用账户及签署募集资金专户存储监管协议等相关事宜。保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事项出具了无

异议的核查意见,该事项已于 2025 年 5 月 28 日经公司 2024 年年度股东会审议通过。具体内容详见公司于上海证券交易所(www.sse.com.cn)披露的《晶合集成关于终止部分募投项目并变更募集资金至其他募投项目的公告》(公告编号:2025-002)、《晶合集成 2024 年年度股东会决议公告》(公告编号:2025-030)。

(二) 募集资金合规情况

公司 2026 年上半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》、公司《募集资金管理制度》等法律法规和制度文件的规定,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况,不存在违规使用募集资金的情形。

十、控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

2026 年 1-6 月,控股股东、实际控制人和董事、高级管理人员持有公司股份不存在变动的情况。

截至 2026 年 6 月 30 日,晶合集成控股股东、实际控制人和董事、高级管理人员持有的公司股权均不存在质押、冻结及减持的情形。

十一、上海证券交易所或保荐机构认为应当发表意见的其他事项

截至本持续督导跟踪报告出具之日,公司不存在保荐机构认为应当发表意见的其他事项。

（以下无正文，为《中国国际金融股份有限公司关于合肥晶合集成电路股份有限公司 2026 年半年度持续督导跟踪报告》之签章页）

保荐代表人：

周玉

周 玉

李义刚

李义刚

中国国际金融股份有限公司

2026 年 9 月 4 日

